DESAIN DAN SIMULASI PERLINDUNGAN PROPERTI INTELEKTUAL MENGGUNAKAN ALGORITME FILTER DIGITAL

DESIGN AND SIMULATION OF INTELECTUAL PROPERTIES PROTECTION USING DIGITAL FILTER ALGORITHM

TUGAS AKHIR

Disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik pada Program Studi S1 Sistems Komputers Universitas Telkom

oleh

HANJARA CAHYA ADHYATMA 1104131113



FAKULTAS TEKNIK ELEKTRO
UNIVERSITAS TELKOM
BANDUNG
2017

DESAIN DAN SIMULASI PERLINDUNGAN PROPERTI INTELEKTUAL MENGGUNAKAN ALGORITME FILTER DIGITAL

DESIGN AND SIMULATION OF INTELECTUAL PROPERTIES PROTECTION USING DIGITAL FILTER ALGORITHM

TUGAS AKHIR

Disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik pada Program Studi S1 Sistems Komputers Universitas Telkom

oleh

HANJARA CAHYA ADHYATMA 1104131113



FAKULTAS TEKNIK ELEKTRO
UNIVERSITAS TELKOM
BANDUNG
2017

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir ini di	ajukan oleh :											
Nama	: H	Ianjara Cahya Ad	dhyatma									
NIM	: 1	: 1104131113										
Program Studi	: S	1 Sistems Komp	uters									
Judul Tugas Akhir	: Г	DESAIN DAN	SIMULASI	PERLINDUNGAN								
	P	PROPERTI INT	ELEKTUAL	MENGGUNAKAN								
	A	ALGORITME FI	LTER DIGITA	L								
ebagai bagian per Yeknik pada Progr Iniversitas Indone	am Studi S1 Siste	-		•								
	DEWA	AN PENGUJI										
Pembimbing	: Prof. XXXX	()									
Penguji	: Prof. XXX	()									
Penguji	: Prof. XXXX	()									
Penguji	: Prof. XXXXX	X ()									
@todo												
	engisi nama para p	enguji.										

Ditetapkan di : Depok

: XX September 2017

Tanggal

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

NAMA : Hanjara Cahya Adhyatma

NIM : 1104131113

ALAMAT : Komplek BPI Blok E1 No. 16 RT 05 RW 06 Kabupaten

Pandeglang, Banten

No. TLP/HP : +6285201740588

E-MAIL : adhyatma.han@gmail.com

Menyatakan bahwa Tugas Akhir II ini merupakan karya orisinal saya sendiri dengan judul:

DESAIN DAN SIMULASI PERLINDUNGAN PROPERTI INTELEKTUAL MENGGUNAKAN ALGORITME FILTER DIGITAL

DESIGN AND SIMULATION OF INTELECTUAL PROPERTIES PROTECTION USING DIGITAL FILTER ALGORITHM

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap kejujuran akademik atau etika keilmuan dalam karya ini, atau ditemukan bukti yang menunjukkan ketidak aslian karya ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah Nya serta nikmat sehat dan nikmat waktu sehingga buku ini dapat diselesaikan. Ucapan terima kasih juga diperuntukkan untuk orang tua dan saudara saudara saya yang telah memberikan semangat, serta teman-teman yang telah membantu dalam pengerjaan buku ini. Ucapan terima kasih juga diperuntukan kepada Dosen-dosen pembimbing Tugas Akhir Telkom University yang memberikan masukan dan saran terhadap buku ini.

Buku penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan ilmu teknologi serta keamanan dalam bidang System-on-Chip (SoC) yang masih jarang dikembangkan di Indonesia.

Bandung, 1 Juli 2017

Hanjara Cahya Adhyatma

ABSTRAK

System on a Chip (SoC) adalah sebuah modul embedded system yang memiliki fungsi tertentu dalam sebuah papan chip silicon yang juga bisa disebut dengan Veri Large Scale Integration (VLSI). Pemilik dari desain SoC memiliki hak cipta atas desain sistem yang telah dibuat. Fabless manufacturing merupakan cara pencetakan modul perangkat keras yang desainer Integrated Circuit (IC) adalah Outsourching dari luar pabrik percetakan.

Fabless manufacturing dari desain IC memiliki celah pencurian desain ketika desain akan dicetak atau ketika proyek membutuhkan mutiple module dengan berbagai fungsi dari berbagai desainer. Oleh karena itu setiap modul VLSI dari desainer chip ini membutuhkan bukti ownership dari perancang atau perusahaan produksi.

Dalam penelitian ini berencana membuat rancangan verifikasi ownership dengan 2 kunci khusus verifikasi yaitu Polygate sebagai kunci utama yang akan mengaktifkan kunci kedua, dan kunci kedua akan aktif yang prosesnya menggunakan algoritme filter digital.

Kata Kunci: VLSI, Intelectual Property Protection, Digital Signal Processing, Polygate Watermark.

ABSTRACT

System on a Chip (SoC) is an embedded system module Has a certain functionality in a silicon chip board that can also be called With Veri Large Scale Integration (VLSI). The owner of the SoC design has Copyright over the system design that has been created. Fabless manufacturing is How to mold a hardware module that is designer Integrated Circuit (IC) Is Outsourching from outside the printing factory.

Fabless manufacturing from IC design has gap design theft When the design will be printed or when the project requires mutiple module With various functions from various designers. Therefore every module is VLSI From this chip designer requires proof of ownership from the designer or Production company.

In this study plans to make a verification of ownership design With 2 dedicated verification keys ie Polygate as the primary key going Activate the second key, and the second key will be active which process Using a digital filter algorithm.

Keywords: VLSI, Intellectual Property Protection, Digital Signal Processing, Polygate Watermark.

DAFTAR ISI

H	ALAN	MAN JUL	DUL	j
LI	E MB A	AR PENG	GESAHAN	ii
LI	E MB A	AR PERN	YATAAN ORISINALITAS	iii
K	ATA l	PENGAN	TAR	iv
\mathbf{A}	BSTR	AK		v
Da	aftar l	[si		vii
Da	aftar (Gambar		ix
Da	aftar '	Fabel		X
1	PEN	DAHUL	UAN	1
	1.1	Latar Be	lakang	1
	1.2		lahan	
			Rumusan Masalahan	
			Batasan Permasalahan	
	1.3			
	1.4		ogi Penelitian	
	1.5		ika Penulisan	
2	TIN	JAUAN P	PUSTAKA	5
	2.1	Very Lar	ge Scale Integration	5
		2.1.1	Arus Pengembangan LSI	5
		2.1.2	Kemungkinan Serangan Desain LSI	7
		2.1.3	Mengatasi Serangan terhadap Desain LSI	7
	2.2	Teknik F	Proteksi	9
		2.2.1	DSP (Digital Signal Processing) Filter	9
		2.2.2	Polimorphisme Gate	9
	2.3	Peralata	n dan Teknologi	9
		2.3.1	Verilog HDL	10

				viii
		2.3.2	YOSYS	. 10
		2.3.3	Electric VLSI	. 10
		2.3.4	FPGA Elbert V2 Board	. 10
	2.4	Target	IP Core	. 11
		2.4.1	ALU (Aritmatic Logic Unit)	. 11
3	DES	SAIN DA	AN SIMULASI	12
	3.1	Desain	1	. 12
		3.1.1	Skema Perlindungan	. 15
		3.1.2	Spesifikasi	. 16
	3.2	Simula	asi	. 17
4	PEN	IGUJIA	AN DAN ANALISIS	18
	4.1	Penguj	jian	. 18
		4.1.1	Sekenario Pengujian	. 18
		4.1.2	Hasil Pengujian	. 18
	4.2	Analis	is	. 18
5	KES	SIMPUI	LAN DAN SARAN	19
	5.1	Kesim	pulan	. 19
	5.2	Saran		. 19
Da	ıftar 1	Referen	ısi	20
LA	AMPI	RAN		1
La	mpir	an 1		2

DAFTAR GAMBAR

2.1	Produksi Cnip Moderen	C
2.2	Clonning/Sumber Tidak Terpercaya	7
2.3	RE (Reverse Engineering)	7
2.4	Model Bisnis Lama	8
2.5	Model Bisnis Baru	8
2.6	Polymorph gate	9
2.7	Tampilan Electric VLSI	10
2.8	FPGA Board - Elbert V2	11
3.1	Skema Perancangan Umum Proses Desain	12
3.2	Skema Perancangan dari Sub Proses Desain	13
3.3	Skema Perancangan dari Sub Proses Desain	13
3.4	Skema Perancangan dari Sub Proses Desain	14
3.5	Skema Perancangan dari Sub Proses Desain	14
3.6	Arsitektur watermark	15
3.7	Aktifasi	15
3.8	Arsitektur watermark off	16
3.9	Arsitektur watermark on	16

DAFTAR TABEL

1 Add	caption																																2
-------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

BAB 1 PENDAHULUAN

Membuat desain IC membutuhkan sumber daya yang sangat banyak, serta prosedur dan ketelitian yang tinggi. oleh karena itu dalam prosesnya dibutuhkan pengamanan agar desain tidak mudah dicuri yang akan menimbulkan kerugian bagi produsen IC tersebut.

1.1 Latar Belakang

Integrated Circuit (IC) merupakan modul teknologi dasar dari perangkat elektronika tertanam modern. Dengan berkembangnya teknologi IC yang mengutamakan ukuran kecil, dan performa yang tinggi serta dengan harga yang murah membuat teknologi IC semakin diminati [1].

Dengan ukuran modul yang sangat kecil dan banyaknya komponen pembangun, kerja sama antara desainer dilakukan untuk membangun sebuah modul VLSI sehingga setiap desainer dapat fokus mendesain salah satu fungsi yang terdapat dalam modul tersebut. Kerja sama dilakukan untuk mempermudah pembuatan desain VLSI yang memiliki tingkat kerumitan yang tinggi. Desainer juga dapat mempercepat waktu mendesain dengan menggunakan kode sumber yang sudah ada atau bekerja sama secara paralel membuat masing-masing modul yang nantinya akan digabung menjadi sebuah modul utama VLSI.

Setelah modul selesai dibuat maka modul siap untuk di-produksi. Dalam proses produksi modul perusahaan tempat desainer bekerja tidak perlu memiliki pabrik produksi modul sendiri, perusahaan dapat bekerja sama dengan mitra percetakan yang akan memproduksi modul buatan perusahaan modul tersebut. Cara kerja sama seperti ini disebut dengan Fabless Manufacturing [2]. Ketika akan memproduksi IC, perusahaan harus menyerahkan blueprint modul VLSI ke percetakan, namun blueprint tersebut tidak terjamin kerahasiaan nya serta memungkinkan plagiarisme desain oleh oknum perusahaan atau pihak ketiga yang tertarik menggunakan desain VLSI yang telah diserahkan untuk di-produksi.

Dengan memberikan rangkaian watermark sebagai pengamanan pada blueprint VLSI siap cetak yang menandakan kepemilikan dari desainer atau perusahaan produsen modul akan melindungi dari kecurangan pihak lain yang akan mencuri desain. Sehingga kemungkinan pencurian atau plagiarisme yang menyebabkan ke-

rugian pada perusahaan atau desainer karena desain nya dicuri atau di-plagiat berkurang

1.2 Permasalahan

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai definisi permasalahan yang Hanjara Cahya Adhyatma hadapi dan ingin diselesaikan serta asumsi dan batasan yang digunakan dalam menyelesaikannya. Berikut ini dijelaskan rumusan masalah yang dihadapi dalam penelitian Intelectual Property Protection (IPP) menggunakan metode Digital Filter Algorithm:

1.2.1 Rumusan Masalahan

Berikut ini dijelaskan rumusan masalah yang dihadapi dalam penelitian Intelectual Property Protection (IPP) menggunakan metode Digital Filter Algorithm:

- Dengan metode Fabless Manufacturing, desain modul yang siap diproduksi diserahkan kepada perusahaan percetakan mitra sehingga mitra dapat mengetahui desain modul dari desainer yang memungkinkan desain dapat dicuri oleh oknum percetakan atau pihak ketiga yang tertarik dengan desain tersebut.
- 2. Desain modul rawan terhadap plagiarisme karena desain elektronik sangat mudah ditiru, sehingga pengamanan desain harus dilakukan agar desain tidak mudah untuk dicuri atau di-plagiat.
- Apabila pihak ketiga mencuri desain, desainer dapat mengklaim modul tersebut dengan bukti dari pengamanan watermark yang telah tertanam dalam IC menggunakan teknik pemanggilan watermark yang hanya diketahui oleh desainer yang mendesain IC tersebut.

1.2.2 Batasan Permasalahan

Dalam penelitian ini rancangan desain VLSI yang disisipkan watermark membatasi masalah serta pembahasan yang akan diteliti sebagai berikut :

- 1. Tidak membuat modul IC VLSI spesifik, namun menggunakan yang sudah ada dan menyisipkan dengan watermark.
- 2. Menyisipkan rangkaian dengan data watermark dan tidak membahas detail data dari pemilik cipta.

3. Watermarking yang dilakukan untuk satu chip IC dan tidak mewatermark masing-masing modul yang ter-integrasi dalam chip IC.

1.3 Tujuan

Berikut merupakan tujuan pengamanan desain modul yang siap cetak sehingga aman terhadap pencurian hak cipta :

- 1. Merancang rangkaian pengamanan dalam sebuah chip design sebagai bukti kepemilikan desain (ownership) atau watermarking.
- Desain chip yang telah diberi rangkaian watermark akan dianalisis perubahan performa dari desain sebelum dan sesudah watermarking serta kemungkinan watermark di-modifikasi oleh pihak lain atau reverse engineering untuk digunakan kembali oleh pengguna yang tidak sah.
- 3. Rangkaian ini akan ditanam di dalam chip yang pemanggilan informasi pemilik dari chip hanya diketahui oleh pemilik cipta.

1.4 Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah perancangan dan prototyping dan percobaan untuk membuktikan hipotesis yang ada.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan adalah sebagai berikut:

• Bab 1 PENDAHULUAN

Berisi tentang uraian latar belakang, rumusan serta batasan masalah dan gambaran umum tentang penelitian sebelumnya yang sudah ada.

• Bab 2 TINJAUAN PUSTAKA

Menjelaskan penjelasan singkat tentang LSI dan proses pembuatannya serta kemungkinan serangan dan cara mengatasinya. Cara mengatasi dari penelitian sebelumnya yang sudah ada dan cara yang diajukan oleh penulis.

• Bab 3 DESAIN DAN SIMULASI

Penjelasan detail tentang desain yang di ajukan penulis untuk mengatasi pembajakan desain serta simulasi hasil dari perancangan desain yang diajukan.

• Bab 4 PENGUJIAN DAN ANALISIS

Hasil pengujian terhadap desain yang diajukan penulis serta analisis terhadap desain yang diajukan.

• Bab 7 KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan yang didapat dari hasil pengujian desain yang diajukan dan saran untuk pengembangan riset dimasa mendatang.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Membuat desain sebuah perangkat IC membutuhkan proses yang panjang dan sumberdaya manusia yang banyak, serta tingkat ketelitian yang tinggi. Oleh karenanya di butuhkan biaya yang tidak kecil dan waktu yang cukup lama hanya untuk membuat sebuah desain IC. Dengan kerumitan yang tinggi serta waktu yang lama dalam setiap prosesnya kadang pihak yang tak bertanggung jawab melakukan kecurangna dengan mecuri desain untuk memotong waktu dan biaya yang di butuhkan utuk produksi. sehingga menjadi masalah dalam dunia permanufakturan ic. [3]

2.1 Very Large Scale Integration

Very Large Scale Integration atau disingkat LSI merupakan proses pembuatan sebuah IC dengan mengkombinasikan ribuan transistor ke dalam sebuah chip. VLSI ada sejak tahun 1970-an ketika semikonduktor kompleks dan teknologi komunikasi sedang berkembang. Mikroprosesor merupakan salah satu peraangkat VLSI. Sebelum adanya teknologi VLSI kebanyakan IC memiliki set fungsi yang terbatas yang dapat di jalankan. Sebuah perangkat chip elektronik dahulu hanya fokus pada sebuah fungsi seperti CPU, ROM, RAM dan rangkaian logika lainnya. Dengan adanya VLSI memungkinkan disainer IC untuk menambahkan berbagai fungsi kedalam sebuah chip IC. [2]

2.1.1 Arus Pengembangan LSI

Integrated Circuit (IC) merupakan teknologi sirkuit elektronika yang lebih maju. Sebuah rangkaian elektronika dibuat dari berbagai komponen elektronika yang berbeda beda seperti transistor, resistor, kapasitor dan dioda yang saling tersambung satu sama lain. [2]

Transistor merupakan komponen terpenting pada pengembangan teknologi komputer moderen. Sebelum ditemukannya transistor. Para Engineer harus menggunakan tabung vakum. Tabung vakum dapat bekerja sebagai saklar elektronik. Namun tabung vakum membutuhkan daya dan ruang yang besar, mahal, serta kemampuan eksekusi yang lambat membuat tabung vakum tergantikan oleh transistor.

Dengan ditemukannya transistor yang ukuran dan kebutuhan dayanya yang kecil namun tetap efektif, Para Engineer elektronik di tahun 1950an melihat banyak

sekali kemungkinan untuk implementasinya pada rangkaian elektronik yang lebih maju. Dengan semakin meningkatnya kompleksitas pada rangkaian elektronik munculah masalah-masalah baru.

Salah satunya adalah ukuran rangkaian. Sebuah rangkaian kompleks seperti komputer sangat bergantung pada kecepatan. Apabila jumlah komponen pada komputer terlalu banyak maka sambungan antar komponen juga semakin banyak dan semakin panjang, sehingga menyebabkan kecepatan transfer sinyal listrik menjadi berkurang yang menyebabkan proses pada komputer menjadi lambat.

Tahun 1958 masalah ini dapat dipecahkan oleh ide Jack S Kilby yang idenya adalah merangkai komponen elektronika dalam sebuah blok silikon (Monolithic Idea). Idenya tersebut tidak hanya mengurangi ukuran rangkaian namun juga mengurangi kebutuhan kabel sambungan antar rangkaian serta manufakturingnya dapat diautomasi. Akan tetapi idenya tersebut masih memiliki banyak masalah lain. Walaupun begitu, idenya tersebut mendapatkan penghargaan nobel di tahun 2000.

Setengah tahun setelah Kilby mencetuskan idenya tentang rangkaian Monolithic. Robert Noyce memiliki jawaban untuk beberapa permasalahan pada ide Kilby. Yaitu interkoneksi antar rangkaian. Yaitu menambahkan lapisan metal pada lapisan terakhir dan menghilangkan sebagian lapisannya sehingga sambungan antar komponen dapat terbentuk.

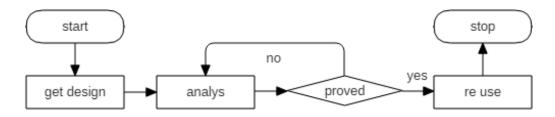


Gambar 2.1: Produksi Chip Moderen

Chip pada zaman sekarang berbasis pada photolithography. Pada teknik ini digunakan radiasi sinar Ultra Violet yang melewati sebuah mask menuju lembaran silikon yang di lapisi filem photosensitive untuk membentuk suatu rangkaian.

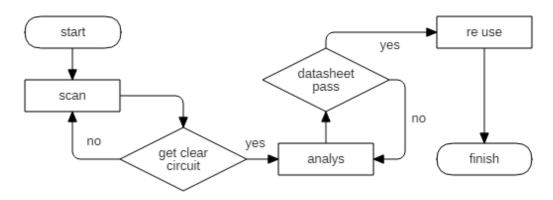
2.1.2 Kemungkinan Serangan Desain LSI

Terdapat banyak kemungkinan serangan dalam proses manufakturing desain LSI. Berikut beberapa contoh serangan terhadap LSI desain.



Gambar 2.2: Clonning/Sumber Tidak Terpercaya

Dalam segi ini serangan dilakukan dengan cara mencuri langsung desain yang sudah siap di fabrikasi serta uji coba kebenaran. Bila pencuri mendapatkan desain yang telah di uji coba, maka pencuri tinggal langsung memperbanyak desain yang telah di curi.



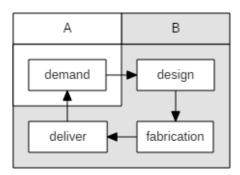
Gambar 2.3: RE (Reverse Engineering)

Untuk serangan jenis ini, pencuri sudah pendapatkan produk dari pasar yang telah teruji, pencuri tinggal melakukan scan rangkaian kemudian mengujinya dengan datasheet. Apabila hasil scan desain produk di dapati rangkaian yang konkrit/jelas dan rangkaian tersebut telah teruji sesuai datasheet. Maka pencuri tinggal melakukan fabrikasi.

2.1.3 Mengatasi Serangan terhadap Desain LSI

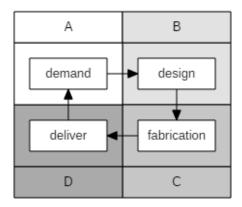
Dengan meninjau kemungkinan dari tipe serangan, terdapat berbagai cara untuk mengatasi setiap serangan serangan tersebut. Dari reverse engineering hingga

untrust source. untuk reverse enginering digunakan teknik anti reverse engineering dan untuk untrust source digunakan teknik identifier dan dengan enclosure agreement law.



Gambar 2.4: Model Bisnis Lama

Pada model gambar diatas, kegiatan desain, fabrikasi dan deliveri di lakukan oleh satu pihak yang sama. Proses pembuatan suatu perangkat IC dimonopoli oleh 1 perusahaan. Sehingga kemungkinan serangan hanya ada di antara pihak A dan Pihak B.



Gambar 2.5: Model Bisnis Baru

Namun seiring dengan perkembangnya jaman. Monopoli proses dari desain, fabrikasi hingga deliveri mulai sulit di terapkan. Karena dengan semakin berkembangnya jaman dan deman akan fitur desain semakin tinggi, otomatis biaya semakin tinggi dan kompleksitas suatu desain semakin rumit serta waktu untuk menyelesaikan suatu desain semakin lama.

Oleh karena itu sekarang mulai diterapkan Fabless manufakturing atau joint venture untuk membuat suat perangkat elektronika. Setidaknya pada proses bis-

nis ini terdapat 4 pihak. Pihak A dari keinginan pasar, pihak B yang melakukan perancangan desain, pihak C yang elakukan fabrikasi hasil rancangan pihak B dan Pihak D yang melakukan deliveri hasil fabrikasi di pihak C ke A.

2.2 Teknik Proteksi

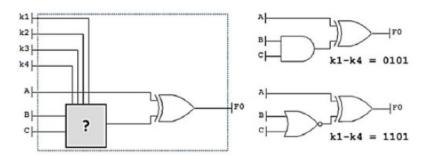
Dari berbagai teknik yang telah digunakan, penulis melakukan penggabungan 2 teknik pengamanan dalam sebuah desain IC. Dalam penelitian ini dilakukan penggabungan 2 teknik agar cakupan wilayah keamanan sebuah IC semakin luas. Berikut teknik yang digabungkan dalam penelitian kali ini.

2.2.1 DSP (Digital Signal Processing) Filter

DSP merupakan teknik pengolahan sinyal untuk sinyal digital.

2.2.2 Polimorphisme Gate

Polimorphisme merupakan teknik pengecoh yang di gunakan dalam perlindungan desain IC.



Gambar 2.6: Polymorph gate

2.3 Peralatan dan Teknologi

Dalam penelitian kali ini dibutuhkan beberapa peralatan dan standard teknologi untuk mengembangkan teknik perlindungan intelektual properti. Sebagai penunjang dalam pembuatan perlindungan, penulis menggunakan tools dan teknologi yang umum digunakan dalam proses pengembangan desain LSI.

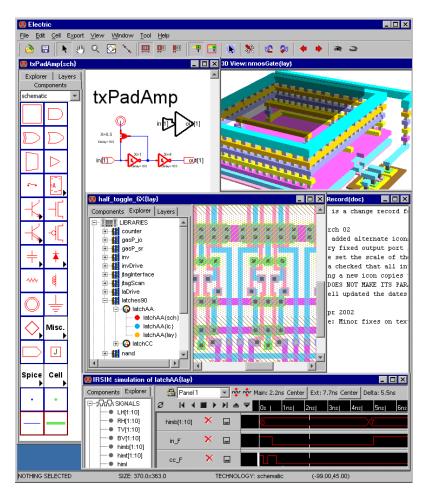
2.3.1 Verilog HDL

Verilog HDL merupakan bahasa pendeskripsi hardware yang di rancang untuk mendeskripsikan suatu rancangan perangkat keras pada gate-lavel dalam bentuk bahasa manusia *walaupun enggak begitu manusiawi

2.3.2 YOSYS

YOSYS adalaha...

2.3.3 Electric VLSI

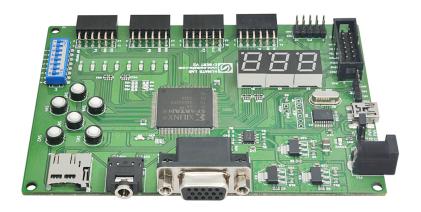


Gambar 2.7: Tampilan Electric VLSI

2.3.4 FPGA Elbert V2 Board

FPGA merupakan kepanjangan dari Field Programmable Gate Array adalah perangkat keras yang biasa digunakan dalam proses manufakturing IC. FPGA digunakan untuk mensimulasikan draft rancangan IC yang siap untuk di test yang

apabila telah lolos test akan di lanjutkan ke tahap layout. FPGA hanya digunakan apabila rancangan membutuhkan input dari perangkat lain atau program kernel.



Gambar 2.8: FPGA Board - Elbert V2

Elbert V2 merupakan Board yang simple namun serbaguna untuk pembelajaran atau pengembangan. Board ini menggunakan Xilinx Spartan 3A FPGA. Pada Development Board ini memiliki fitur FPGA dari Xilinx XC3S50A dengan 144 pin dengan maksimum 108 user IO. Dilengkapi dengan antarmuka USB2 untuk kemudahan konfigurasi ke SPI flash.

2.4 Target IP Core

Watermark adalah rangkaian yang tidak dapat berdiri sendiri pada implementasinya walaupun dalam pengembangannya bisa di lakukan mandiri. Watermark dalam bentuk data signature.

2.4.1 ALU (Aritmatic Logic Unit)

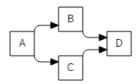
Aritmatik Logic Unit atau dapat di singkat sebagai ALU merupakan salah satu komponen utama dalam prosesor. ALU berfungsi sebagai Unit yang melakukan kalkulasi logika artimatika.

BAB 3 DESAIN DAN SIMULASI

Perancangan serta langkah-langkah di perlukan untuk menyelesaikan penelitian ini. Berikut ini akan di jelaskan gambaran serta tahapan dari perancangan system yang di teliti serta skenario simulasi dari hasil desain yang telah dirancang.

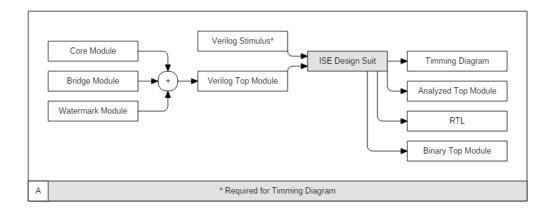
3.1 Desain

Secara garis besar pada sisi desainer, terdapat 3 langkah untuk melakukan pengembangan alat dari programming hingga layout siap cetak. Penulis menggunakan cara ini dari hasil studi serta eksperimen saat proses pengembangan alat.



Gambar 3.1: Skema Perancangan Umum Proses Desain

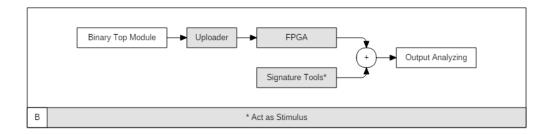
Pada langkah pertama dilakukan proses A, penulis melakukan perancangan desain dari IC yang akan di watermark kemudian di lakukan analisis. Apabila pertama telah selesai, penulis akan melakukan langkah kedua. Pada langkah kedua ini di lakukan kegiatan B yaitu proses ferifikasi dengan FPGA dan kegiatan C yaitu proses syntesys menjadi Raw Layout. Setelah kegiatan B dan C selesai maka kegiatan D yaitu proses finalisasi layout dapat dilakukan yang akhirnya hasil final layout dapat di serahkan ke pabrik untuk di fabrikasi.



Gambar 3.2: Skema Perancangan dari Sub Proses Desain

Secara umum pada kegiatan A, penulis membuat 3 module verilog untuk digabungkan. Core Module yaitu program rangkaian ALU, Watermark Module adalah program untuk watermarking dan Bridge Module untuk menghubungkan output antara Core Module dan Watermark Module. Setelah selesai dilakukan programming setiap medule tersebut maka medul-modul tadi digabungkan menjadi Top Module. Top Module ini lah yang nantinya akan menjadi IC terwatermark.

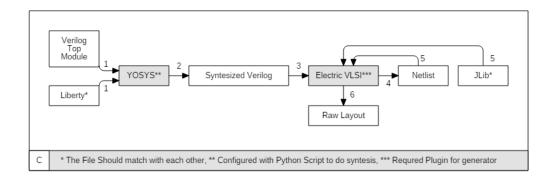
Pada top module ini harus diberikan program tambahan yaitu stimulus untuk dapat mensimulasikan skenario Input dan Output dari Top Module. Bila sekenario stimulus telah dibuat, kemudian dilakukan simulasi dengan bantuan softwere ISE design suit untuk melihat hasil simulasi berupa Timming diagram. Pada Timming Diagram inilah dapat di lihat apakah sekenario dari Input dan Output sesuai dengan keinginan. Setelah hasil analisis sesuai dengan yang diinginkan maka dilanjutkan dengan kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan B dan C.



Gambar 3.3: Skema Perancangan dari Sub Proses Desain

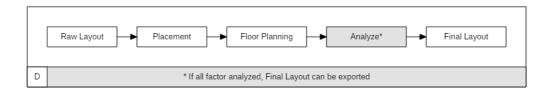
Pada kegiatan B ini dilakukan simulasi ferivikasi pada board FPGA dengan alat ferifikasi. kegiatan ini dilakukan untuk simulasi ferifikasi signature pada IC yang telah diwatermark. IC yang telah diwatermak di tanam pada FPGA dan dengan menggunakan Signature Tools dilakukan ferifikasi sehingga didapat data signature

dari IC yang telah di watermask.



Gambar 3.4: Skema Perancangan dari Sub Proses Desain

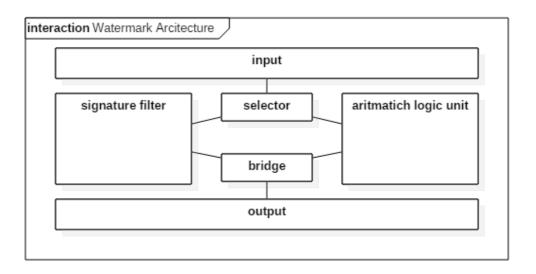
Untuk kegiatan C dilakukan developing layout dari Top Module yang telah diferifikasi dengan timming diagram. Defeloping menggunakan softwere Electric VLSI. Dengan mensyntesis Verilog Top Module dan Liberty file menggunakan YOSYS, maka akan di dapat file verilog tersyntesis. Kemudian File tersintesis tersebut di Load di Electric VLSI untuk di rubah ke NetList. Setelah berhasil di rubah menjadi NetList maka file NetList tersebut di kompilasi bersama file JLib pada electric VLSI untuk di jadikan Raw Layout.



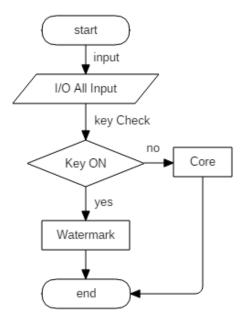
Gambar 3.5: Skema Perancangan dari Sub Proses Desain

Pada tahap ini di lakukan kegiatan C yaitu memproses Raw Layout menjadi Final Layout yang siap di cetak. Tahapan nya adalah melakukan placement untuk setiap modulnya lalu di lakukan analisis kemudian dilakukan Floor planning. Setelah itu dilakukan analisis kembali hingga didapat hasil yang terbaik. Apabila telah didapat hasil yang terbaik maka File siap untuk difabrikasi.

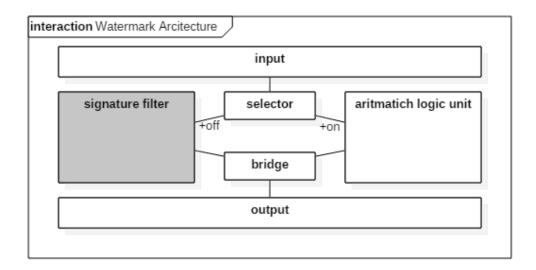
3.1.1 Skema Perlindungan



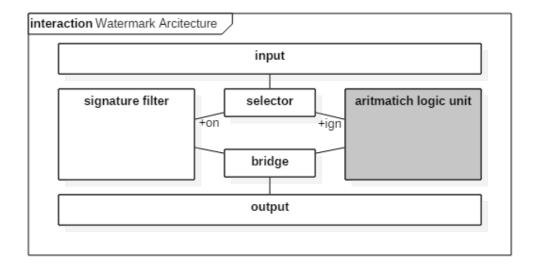
Gambar 3.6: Arsitektur watermark



Gambar 3.7: Aktifasi

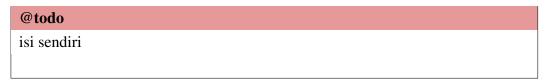


Gambar 3.8: Arsitektur watermark off



Gambar 3.9: Arsitektur watermark on

3.1.2 Spesifikasi



3.2 Simulasi

@todo

jelasin dan tampilin simulasi apa aja yang bakal gw lakuin disini

BAB 4 PENGUJIAN DAN ANALISIS



4.1 Pengujian

@todo

Tampilkan macam macam hasil pengujian yang telah di lakukan

4.1.1 Sekenario Pengujian

@todo

tambahin kata kata

4.1.2 Hasil Pengujian

@todo

tambahin kata kata

4.2 Analisis

@todo

Tampilkan macam macam hasil analisis dari setiap pengujian

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

@todo

Tambahkan kesimpulan dan saran terkait dengan perkerjaan yang dilakukan.

5.1 Kesimpulan

@todo

tambahin kata kata

5.2 Saran

@todo

tambahin kata kata

DAFTAR REFERENSI

- [1] Jeff Clark. (n.d). *Introduction to LaTeX*. 26 Januari 2010. http://frodo.elon.edu/tutorial/tutorial/node3.html.
- [2] "The History of the Integrated Circuit". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 25 Aug 2017. http://www.nobelprize.org/educational/physics/integrated_circuit/history/.
- [3] Leonid Azriel, Student Member, Ran Ginosar, Senior Member, and Shay Gueron. Using Scan Side Channel to Detect IP Theft. pages 1–13, 2017.
- [4] Abhishek Basak, Swarup Bhunia, Senior Member, Thomas Tkacik, Sandip Ray, and Senior Member. Security Assurance for System-on-Chip Designs With Untrusted IPs. 12(7):1515–1528, 2017.
- [5] Mohammad-mahdi Bidmeshki, Xiaolong Guo, Raj Gautam Dutta, Yier Jin, and Yiorgos Makris. Tracking in Proof-Carrying Hardware IP Part II: 12(10):2430–2443, 2017.
- [6] Xi Chen, Gang Qui, Aijiao Cui, and Carson Dunbar. Scan Chain based IP Fingerprint and Identification. 2017.
- [7] Xiaoming Chen, Qiaoyi Liu, Yu Wang, Qiang Xu, and Huazhong Yang. Low-Overhead Implementation of Logic Encryption Using Gate Replacement Techniques. 2017.
- [8] Jeffrey T Dellosa. The Impact of the Innovation and Technology Support Offices (ITSOs) on Innovation, Intellectual Property (IP) Protection and Entrepreneurship in Philippine Engineering Education. (April):762–770, 2017.
- [9] Xiaolong Guo, Student Member, Raj Gautam Dutta, Student Member, and Yier Jin. Eliminating the Hardware-Software Boundary: A Proof-Carrying Approach for Trust Evaluation on Computer Systems. 12(2):405–417, 2017.
- [10] Yier Jin, Xiaolong Guo, Raj Gautam Dutta, Mohammad-mahdi Bidmeshki, and Yiorgos Makris. Tracking in Proof-Carrying Hardware IP Part I:. 12(10):2416–2429, 2017.

- [11] Jian Lin. Analysis of the Key Factors of Intellectual Property Management at Art Institutions. pages 206–208, 2017.
- [12] Hardware Matters. Antipiracy-Aware IP Chip Set Design for CE Devices: A Robust Watermarking Approach. (april):118–124, 2017.
- [13] Hardware Matters. Hardware Security of CE Devices. (January), 2017.
- [14] By Saraju P Mohanty and Rochester Chapters. Information Security and IP Protection Are Increasingly Critical in the Current Global Context. (June):3–5, 2017.
- [15] By Saraju P Mohanty and Rochester Chapters. Information Security and IP Protection Are Increasingly Critical in the Current Global Context. (June):3–5, 2017.
- [16] Xuan Thuy Ngo, Jean-luc Danger, Sylvain Guilley, Tarik Graba, Yves Mathieu, Zakaria Najm, and Shivam Bhasin. Cryptographically Secure Shield for Security IPs Protection Threats on Integrated Circuits. 66(2):354–360, 2017.
- [17] Xuan Thuy Ngo, Jean-luc Danger, Sylvain Guilley, Tarik Graba, Yves Mathieu, Zakaria Najm, and Shivam Bhasin. Cryptographically Secure Shield for Security IPs Protection Threats on Integrated Circuits. 66(2):354–360, 2017.
- [18] Protection Of, Trade Secrets, Under The, T S Directive, and Protection During. The European Union Trade-Secrets Directive: To-Dos for Companies? (april):2016–2017, 2017.
- [19] A Sengupta and D Roy. Protecting IP core during architectural synthesis using HLT-based obfuscation. 53(13):1–2, 2017.
- [20] A Sengupta and D Roy. Protecting IP core during architectural synthesis using HLT-based obfuscation. 53(13):1–2, 2017.
- [21] Anirban Sengupta, Member Ieee, Dipanjan Roy, Student Member Ieee, and Saraju P Mohanty. Triple Phase Watermarking for Reusable IP Core Protection during Architecture Synthesis. 0070(c), 2017.
- [22] Wei-tek Tsai, Libo Feng, and Hui Zhang. Intellectual-Property Blockchain-based Protection Model for Microfilms. pages 174–178, 2017.
- [23] Nandeesha Veeranna and Benjamin Carrion Schafer. Efficient Behavioral Intellectual Properties Source Code Obfuscation for High-Level Synthesis. 2017.

- [24] Marc Wehlack and Konrad Spang. Motivations for and Barriers to Offshoring Development Projects to China A Case Study of the Automotive Industry. pages 169–173, 2017.
- [25] Muhammad Yasin, Student Member, Ozgur Sinanoglu, and Senior Member. Testing the Trustworthiness of IC Testing: An Oracle-Less Attack on IC Camouflaging. 12(11):2668–2682, 2017.
- [26] Dongrong Zhang, Miao Tony He, Xiaoxiao Wang, and Mark Tehranipoor. Dynamically Obfuscated Scan for Protecting IPs Against Scan-Based Attacks Throughout Supply Chain. 2017.
- [27] Jiliang Zhang and Lele Liu. Publicly Verifiable Watermarking for Intellectual Property Protection in FPGA Design. 25(4):1520–1527, 2017.
- [28] Jiliang Zhang and Lele Liu. Publicly Verifiable Watermarking for Intellectual Property Protection in FPGA Design. 25(4):1520–1527, 2017.



LAMPIRAN 1

Tabel 1: Add caption

Keterangan Type									
n	LITER	METER							
A	10	0,01	0,0215						
В	100	0,1	0,0464						
C	1.000	1	0,1000						
D	10.000	10	0,2154						
E	100.000	100	0,4642						
F	1.000.000	1K	1,0000						
G	10.000.000	10K	2,1544						
Н	100.000.000	100K	4,6416						
I	1.000.000.000	1M	10,0000						
J	10.000.000.000	10M	21,5443						
K	100.000.000.000	100M	46,4159						
L	1.000.000.000.000	1B	100,0000						
M	10.000.000.000.000	10B	215,4435						
N	100.000.000.000.000	100B	464,1589						